

G-34 機械工程學系 98 學年度入學 碩士在職專班 研究生畢業條件明細表

項 目	備 註						
一、修業年限： 1. 最低修業年限：1 年 2. 最高修業年限：4 年（不包括休學年限 2 年）	未在規定修業期限內修滿應修課程或未完成學位論文者，得延長修業年限一年						
二、應修最低畢業總學分共 30 學分，包括下列兩項： 1. 學 科：必修最低 0 學分、選修最低 24 學分 2. 畢業論文： 6 學分	研究生學業及操行成績均以 70 分為及格。操行成績不及格者，予以退學。 學業平均成績佔畢業成績 50% ※必修+選修+畢業論文=最低畢業總學分。						
三、抵免學分：依學校規定	依本校抵免學分辦法，並應於入學當學期加退選課程截止日期前申請抵免。						
四、選修大學部相關課程計入研究所畢業學分	本校學生選課辦法規定：研究生因課業需要，除本系（所）基本應修學分外，經本系（所）主任（所長）與指導教授及開設課程學系主任之同意，報經教務長核可後，得選修大學部相關課程，並於修習通過後計入畢業學分，但以三學分為限。						
五、承認外系（所）學分：依學校規定	含校際選課學分						
六、必修科目及學分數：共 6 學分 <table border="1" style="margin-left: 40px; width: 80%;"> <thead> <tr> <th>科目名稱</th> <th>學分數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 畢業論文(碩士在職專班)【上學期】</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2. 畢業論文(碩士在職專班)【下學期】</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	科目名稱	學分數	1. 畢業論文(碩士在職專班)【上學期】	3	2. 畢業論文(碩士在職專班)【下學期】	3	必修科目不及格應予重修，必修科目未修滿不得畢業。
科目名稱	學分數						
1. 畢業論文(碩士在職專班)【上學期】	3						
2. 畢業論文(碩士在職專班)【下學期】	3						
七、系所指定應補修大學部基礎科目（不計入畢業學分）：共 0 學分	本校研究所碩士班章程規定，研究生應補修之大學部基礎課程，由系主任（所長）及指導教授決定之，但補修及格後，不計入畢業學分。未補修及格前，不得參加學位考試。						
八、碩士學位考試（論文考試）： 1. 研究生入學第一學年結束前，應商請指導教授。 2. 研究生修完最低修業年限且修畢規定課程及學分，並完成研究論文初稿者，得於當學期完成註冊選課後，於預定舉行論文考試日期至少二十天前，提出論文考試申請。論文考試成績以 70 分為及格。	論文考試成績佔畢業成績 50%  論文不及格而修業年限未屆滿者，得於次學年或次學期申請重考一次，重考仍不及格者，予以退學。重考及格者之成績，概以 70 分計算。						
九、其 他： 英語能力畢業標準：依學校規定	依「國立中興大學學生英文能力畢業標準檢定辦法」第 2 條規定，授權系所自訂研究生英語能力畢業標準。（98.3.26 第 57 次教務會議訂定）						

※必修科目及畢業學分數規定，由系所依各學年課程規劃表填列。

※相關章程規定查詢網址：<http://www.nchu.edu.tw/~indodep/chinese/rule.htm>

製表日期：98 年 09 月 24 日

系承辦人：



系主任(所長)簽章：



年 月 日

機械工程學系(所)碩專班畢業條件明細表(98學年度起入學適用) 99.02.10更新

專業選修科目列表

科目名稱	全或半	學分
(1) 製造性設計	半	3
(2) 流體力學理論與計算	半	3
(3) 磨潤工程	半	3
(4) 電腦輔助運動學與動力學	半	3
(5) 數位訊號處理	半	3
(6) 生產工程	半	3
(7) 高等金屬成型理論	半	3
(8) 公差工程	半	3
(9) 高等熱傳學	半	3
(10) 熱流系統設計與分析	半	3
(11) 工程數值法	半	3
(12) 高等機構設計	半	3
(13) 雷射全像光學精密量測	半	3
(14) 熱工系統設計	半	3
(15) 熱對流學	半	3
(16) 模糊控制	半	3
(17) 數位控制系統	半	3
(18) 精密機械設計原理	半	3
(19) 精密加工	半	3
(20) 精密量測	半	3
(21) 機械製造分析	半	3
(22) 微機電系統	半	3
(23) 電腦輔助製造	半	3
(24) 光機電工程概論	半	3
(25) 複合材料力學	半	3
(26) 智慧型機器人	半	3
(27) 實驗應力分析	半	3
(28) 產品設計與工程適用	半	3
(29) 微感測器與微致動器	半	3
(30) 光學原理	半	3
(31) 醫療器材研發	半	3
(32) 量測系統原理與數據分析	半	3
(33) 微系統設計與分析	半	3
(34) 智能材料結構之設計與分析	半	3
(35) 光學系統與元件技術	半	3
(36) 自動光學檢測	半	3

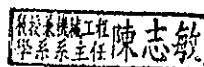
◎備註：

1. 本系最低應選修 24 學分。
2. 以上選修科目來自課程規劃，可能未成班或停開。

系承辦人：



系主任(所長)簽章：



年 月 日